

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、 _____ 殿 _____ に納入する
micro SD カードコネクタ _____ について規定する。

This specification covers the micro SD CARD CONNECTOR series for limited use by _____.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
カードコネクタ CARD CONNECTOR	503182-1842
エンボス梱包品 Embossed Package	503182-1852

【3. 定格 RATINGS】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	10 V	[AC(実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	0.5 A	
使用温度範囲 Ambient temperature Range (Operating and Non-operating)	-25°C ~ +85°C *1	
保管条件 Storage Condition	温度 Temperature	0°C ~ +50°C
	湿度 Humidity	85%R.H. 以下(但し結露しないこと)*2 85%R.H. MAX. (No condensation)
	期間 Term	出荷後6ヶ月(未開封の場合) *3*4 For 6 months after shipment.(Under packed)

*1 : 通電による温度上昇分も含む。

Including terminal temperature rise.

*2 : 保存環境は、塵埃の多い所、腐食性ガスが発生する場所及び結露は避けること。

Storage area is to be free of dust,corrosive gases and dew formation.

*3 : 開封から実装までの許容期間は2週間以内とする。

Permissible period from opening to mounting is made within two weeks.

*4 : 保管期限経過後は半田付け性を確認の上ご使用ください。

Please use solderability after confirmation afterward after a term of storage passed.

REV.	A						
SHEET	1~16						
REVISE ON PC ONLY		TITLE:					
A	新規作成 RELEASED J2013-0986 '13/03/08 Y.GOTO		micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書				
	REV. DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DESIGN CONTROL	STATUS	WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: YR/MO/DAY		
J		Y.GOTO	M.TOMITA	YO.ITO	2013/03/08		
DOCUMENT NUMBER					FILE NAME	SHEET	
PS-503182-006					PS503182006.doc	1 of 16	

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	ダミーカード ^{*1} を嵌合させ、開放電圧 20mV以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate dummy card, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms MAXIMUM
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するピン間及びピン、アース間にDC 500Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Apply 500V DC between adjacent pins or pin and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	隣接するピン間及びピン、アース間に、AC 500V (実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 500V AC for 1 minute between adjacent terminals and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown

*1 ダミーカードとは、当社製の、端子カードパッド間の接触抵抗測定が可能な評価用カードを示す。
The dummy card shows the card for the evaluation made of our company, and makes possible to measure contact resistance.
また、本ダミーカード寸法は、“microSD Memory Card Specification”に準拠する。
The size of dummy card is based upon “microSD Memory Card Specification”.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 2 of 16

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-1	端子、金具保持力 Terminal, nail Retention Force	毎分25±3mmの速さで端子、金具を軸方向に引っ張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25 ±3 mm / minute.	0.49 N MINIMUM / PIN {0.05kgf MINIMUM / PIN}	
4-2-2	挿入力及び抜去力 Insertion / Withdrawal Force	毎分 25±3 mmの速さで実物カード*2を押し。 Push the actually card at the speed rate of 25±3 mm / minute.	カムロック荷重 Lock force	14 N (1.43 kgf) MAXIMUM
			カムロック解除荷重 Lock release force	14 N (1.43 kgf) MAXIMUM

*2 実物カードとは、市販品と同等のmicro SD カードを示す。 Actual card is micro SD card.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 3 of 16

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 (プッシュイン / プッシュアウト) Repeated mate / un-mate (Push in / Push out)	<p>実物カードで、1時間に400~600回の速さで挿入・抜去を10,000回繰り返す。挿抜10回毎に、5~10分休止する。問題がなければ休止時間を短くすることも可能とする。 初回~1,000回は100回毎、1,001回~10,000回は1,000回毎に、エアブローを3秒間行う（乾燥風）。</p> <p>Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the actually card at the speed rate of 400-600 cycles/hour.</p> <p>After each 10 cycles stop the insertion and rest the connector for 5 to 10 minutes.If there is no problem,it is possible to shorten rest time. Air blow card (dry air) for 3secs : at each 100 cycle interval from start to 1,000 cycles. at each 1000 cycle interval from 1,001 to 10,000 cycles.</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM ダミーカードで測定 With the dummy card
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	<p>最大許容電流(0.5A)を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498)</p> <p>Carrying rated current load. (UL 498)</p>	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAXIMUM
4-3-3	耐振動性 Vibration	<p>ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に周波数10~55~10 Hz / 分、全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202試験法 201)</p> <p>Mate actually card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA during the test. Amplitude: 1.52 mm P-P Frequency: 10-55-10 Hz Shall be traversed in 1 minute. (MIL STD-202 Method 201)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

micro SD CONN.
(PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE)
製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-503182-006

FILE NAME

SEE SHEET 1 OF 16

SHEET

4 of 16

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-4	落下衝撃 Fall down test	コネクタを150gのダミー治具に取り付け、高さ150cmの位置からコンクリート面上に6面を1サイクルとして、3サイクル落下させる。 Mount the connector in the dummy case of 160g and drop from height of 150cm on concrete side. 3 times shall be applied along 3 mutually perpendicular axes.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-5	耐 衝 撃 性 Shock	ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に490 m/s ² (50G) の衝撃を各3回加える。 (JIS C60068-2-27 / MIL-STD-202 試験法 213) Mate dummy card and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test. (Total of 18 Shocks) Test pulse: Half Sine Peak value: 490m / s ² Duration: 11 ms (JIS C60068-2-27 / MIL-STD-202 Method 213)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM
4-3-6	耐 湿 性 Humidity	ダミーカードを嵌合させ、+40±2℃、相対湿度90～95%の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 Mate dummy card and subject to the conditions of +40±2℃, relative humidity 90-95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE: micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書
A	SEE SHEET 1 OF 16	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-503182-006	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 5 of 16
---	--------------------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-7	温湿度サイクル Moisture resistance	ダミーカードを嵌合させ、第7項に示す条件にて9サイクル行い、10サイクル目は段階6迄の試験を行う。但し、段階7aは初めの9サイクルのうち任意の5サイクルについて行う。試験後、室温に24時間放置する。 (MIL-STD-202 試験法 106) Mate dummy card and subject to the conditions specified on paragraph [7] for 9 cycles. The test specimens shall be exposed to STEP 7a during only 5 out of 9 cycles. A 10th cycles consisting of only step 1 through 6 is then performed, after which the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions of 24 hours. (MIL-STD-202 Method 106)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MINIMUM
4-3-8	温度サイクル Temperature cycling	ダミーカードを嵌合させ、-55±3°Cに30分、+85±2°Cに30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は3分以内とする。試験後 1~2 時間室温に放置する。 (JIS C0025) Mate dummy card and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) -55±3°C . . . 30 minutes b) +85±2°C . . . 30 minutes Transit time shall be within 3 minutes. (JIS C0025)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-9	耐熱性 Heat Resistance	ダミーカードを嵌合させ、+85±2°Cの雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 試験方法108) Mate dummy card and exposed to +85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 Method 108)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		

DOCUMENT NUMBER PS-503182-006	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 6 of 16
---	--------------------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-10	耐寒性 Cold Resistance	ダミーカードを嵌合させ、-25±3°Cの雰囲気 に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置 する。 (JIS C60068-2-1) Mate dummy card and exposed to -25±3°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-11	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	ダミーカードを嵌合させ、+40±2°C、相対湿度 75%にて25±5ppmの亜硫酸ガス中に96時間 放置する。 Mate dummy card and expose to 25±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature +40±2°C, relative humidity 75% for 96 hours.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-12	塩水噴霧 Salt Spray	ダミーカードを嵌合させ、+35±2°Cにて5±1% 重量比の塩水を48時間噴霧し試験後常温で 水洗いした後、室温で乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate dummy card and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: +35±2°C (MIL-STD-1344)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE: micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書
A	SEE SHEET 1 OF 16	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-503182-006	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 7 of 16
---	--------------------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-13	半田付け性 Solderability	<p>端子先端より0.5mmの位置まで250±5℃の半田に3±0.5秒浸す。 (使用半田 : M705-221BM5-42-11 Sn-96.5/Ag-3.0/Cu-0.5)</p> <p>Dip solder tails into the molten solder (held at 250±5℃) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec. (Type of solder used : M705-221BM5-42-11 Sn-96.5/Ag-3.0/Cu-0.5)</p>	濡れ性 Solder Wetting	<p>浸漬面積の90%以上 90% of immersed area must show no voids, Pinholes</p>
4-3-14	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	<p><リフロー条件> 第6項条件を2回繰り返す。 (When reflowing) Repeat Paragraph6,Condition two times.</p> <p><手半田> こて先温度を380℃とし、3秒以内ではんだ付けする。 (Solder iron method) Solder temperature :380℃ Immersion time: 3 sec. Min.</p> <p>但し、端子に異常のないこと。 However, excessive pressure shall not be applied to the terminal.</p>	外 観 Appearance	<p>端子ガタ、割れ等異常なきこと No Damage</p>

(): 参考規格 Reference Standard
{ }: 参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 8 of 16

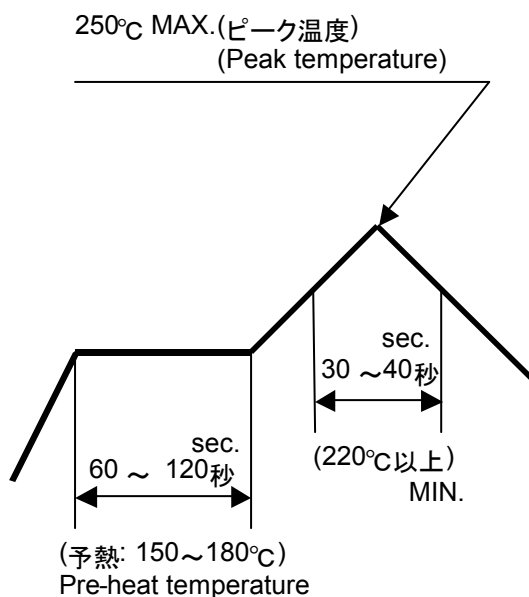
【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照

Refer to the drawing.

【6.リフロー条件 REFLOW CONDITION】

温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH



注記

NOTES

- 1.本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なります。事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。

This reflow condition may change by the actual reflow machine, p.c.boards, and so on. Please check soldering appearance by using your own reflow condition before production because there is a possibility of solder wicking.

- 2.温度条件は、半田接合部とする。

Let temperature conditions be the solder joint of connector.

推奨メタルマスク厚さ : t=0.12mm

Thickness of METAL MASK

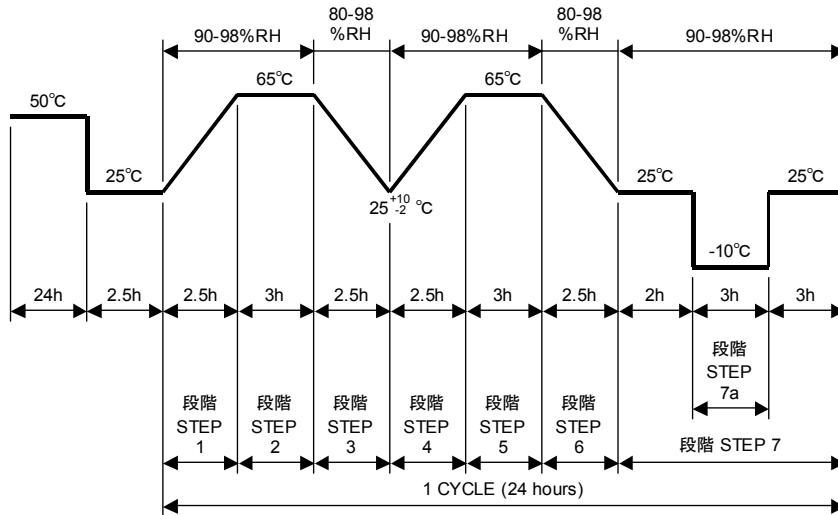
メタルマスク開口率 : 100%

Open aperture ratio

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 9 of 16
EN-037(2012-05)			

【7. 温湿度サイクル試験条件 MOISTURE RESISTANCE CINDITION】

MIL-STD-202 試験法106
MIL-STD-202 Method 106



REVISE ON PC ONLY	
A	SEE SHEET 1 OF 16
REV.	DESCRIPTION

TITLE:	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

DOCUMENT NUMBER	PS-503182-006
-----------------	----------------------

FILE NAME	SEE SHEET 1 OF 16
-----------	-------------------

SHEET	10 of 16
-------	----------

【8. 使用上の注意事項 APPLICATION NOTES】

・ 外観について Externals

1-1 本製品の樹脂部に黒点、ウエルド部の線、多少の傷が確認される事がありますが、製品性能には影響
 ございません。

Although this product may have a small black mark, a weld line or a scratch on the housing, these will
 not have any influence on the product's performance.

1-2 本製品のシェル表面に多少の傷が確認される事がありますが製品性能に影響ございません。

Although this product may have a small scratch on the metal shell, this will have no influence on the
 product's performance.

1-3 本製品の端子は錫めっきを使用しているため、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、製品性能に
 影響はありません。

Because we plate the terminal with Tin, there may be scratch marks on the surface. However, these
 scratches will have no influence on the product's performance.

1-4 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。

There may be slight differences in the housing coloring, but there will be no influence on the product's
 performance.

・ 実装について Mounting and Reflow

2-1 本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより
 条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。実装条件によっては、製品
 性能に影響を及ぼす場合があります。

Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand.
 The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, air reflow
 machine, Nitrogen reflow machine, and the type of printed circuit board. The different mounting
 conditions may have an influence on the product's performance.

2-2 実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両
 端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとして下さい。

The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the printed
 circuit board. The warpage of the printed circuit board should be a maximum of 0.02mm if measuring
 from one connector edge to the other.

2-3 本製品の一般性能確認はリジット基板にて実施おります。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装す
 る場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。

The product performance was tested using rigid printed circuit board. In case the product needs to be
 reflowed onto flexible circuit board, please conduct a reflow test on the flexible circuit board in advance.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 11 of 16
EN-037(2012-05)			

- 2-4 フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。
 コネクタの反り防止のために実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れ
 コネクタを固定して下さいませ様ご配慮願います。また、別途ご相談願います。
 Please add a stiffener on the flexible printed circuit (FPC) when you mount the connector onto FPC in
 order to prevent deformation of the FPC.
 In order to prevent bowing when mounting and using the connector, please ensure to attach a stiffener
 on the back side of connector.
 If there are any questions on this, please consult Molex separately.
- 2-5 リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。
 Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not influence
 the product's performance.
- 2-6 本製品は端子先端部に、カット面がある為に端子先端部の実装性(基板への半田付け性)は、端子側面・
 後側に比べて悪くなります。しかし、側面及び後側においてフィレットが形成されていれば、機能及び
 強度に問題はありません。
 Because this product has a cutoff area on the tip of the terminal, the solderability performance in this
 area is not as good as compared to the side/back of the terminal. However, by building a good
 soldering fillet at the side/back of the terminal, there will be no issue on either the product function or
 the printed circuit board retention force.
- 2-7 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板か
 らの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
 If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal
 short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connector to come off of the
 printed circuit board. Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails on the printed circuit
 board.
- 2-8 カードを挿入した状態、或いはカード無理抜き等によるカムスライダーをロックした状態にて、リフ
 ロー等加熱はしないで下さい。加熱によるストレスによりカードロック機構が破損する恐れがあります。
 Please do not reflow the connector while a card is inside of the connector or while the cam-slider is in
 the locked position after forced card extraction. The heat and stress may cause to damage the card's
 locking mechanism.
- 2-9 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に、注意して下さい。
 After mounting of connectors, please care of not pile up on printed circuit boards which mounted connectors
 directly.
- ・ 製品の仕様について Specification of the product
- 3-1 コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。
 Please do not conduct any "washing process" on the connector because it may damage the product's
 function.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 12 of 16
EN-037(2012-05)			

3-2 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部（接点部）が常に動いてしまう状態でのご使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。

Please do not use the connector in a condition where the wire, the printed circuit board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and printed circuit board, and constant movement of devices. This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and printed circuit board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

3-3 本製品はカードを嵌合した状態で落下させたり、衝撃を加えたりするとカードが抜け出る場合があります。従って、カードが露出したままとなるレイアウトで使用する場合には、筐体にカード抜け防止用の蓋等の対策を施して下さい。その場合、カード嵌合状態でのカードと蓋の隙間は0.3mm以下にして下さい。

When the device is dropped while the card is engaged or an impact is applied to the device, the card may come out of the connector. Therefore, if the card is placed in an exposed layout, we insist on setting up a lid/cap to prevent card from being ejected. In this case, please adjust the spacing to 0.3 mm maximum when the card is in the locked condition.

3-4 カード抜去時にカードを押し込んだ状態から急激に手を放すと、カードがソケット内から飛び出す場合があります。機器に組み込む際には飛出し防止の構造を設けることを推奨いたします。

When a card is being extracted, if the card is held in the over-stroke position and then released rapidly, there is the potential for the card to "fly-out" of the connector. Therefore, when the connector is placed in a device, we recommend that the layout of the device design incorporates some card fly-out prevention structure.

3-5 カードの裏表・前後・縦横の逆挿しをするとカードが抜けない、またはコネクタが破損する恐れがあります。破損防止のためにもカードの向き・方向の表示を実機側にてお願い致します。

If the card is mated reversely, or upside down, there is the potential for the connector to be damaged or for the card to become stuck in the connector. Please clearly show the correct mating direction of the card in the device in order to prevent any damage to the card or the connector.

3-6 異種のカードを挿入するとカードが抜けない、またはコネクタが破損する恐れがあります。破損防止のためにも適合カードの表示を実機側にてお願い致します。

If the wrong type of card is mated into the connector, there is the potential for the connector to be damaged or for the card to become stuck. Please show a description of the applicable card clearly on the device in order to prevent any damage.

3-7 カード挿入、抜去時に図面記載のカード押し込み寸法まで確実に押すように考慮した筐体デザインにして頂きますようお願いいたします。

Please make sure that the design of the phone chassis allows for users to push on the edge of the card when it is in the "card lock position". Users will need this access for inserting and extracting the card. The dimension is listed on the sales drawing.

3-8 適合カードは規格内カードとしカードの厚みはコンタクト部0.8mm MAX.(反りを含む)とする。

The applicable card used in this connector must meet the microSD specification. The thickness of the card needs to be 0.8mm maximum at the contact area (This includes the card warpage).

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 13 of 16
EN-037(2012-05)			

3-9 基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。

Please do not touch the terminals and fitting nails before or after reflowing the connector onto the printed circuit board.

3-10 カードの仕上がり状態や、繰り返し挿抜を連続的に実施した際のカード磨耗により排出がされない場合があります。この場合、カードの姿勢を変化させる、再度押す、カードの清掃を行うなどの処置を行い、排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断しております。

There is a possibility that the card may become stuck in the connector due to the card finish being rough or due to the card becoming worn after consecutive cycling. When this occurs, if the changing of the position of the card, or the pushing of the card in again dislodges the card, or a card is cleaned, it will be judged that the connector has no problem.

3-11 コネクタ内でカードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。内部を破損する恐れがあります。

Please do not extract the card when the card is in the locked position in the connector. This may cause damage to the inside of the connector.

3-12 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットをしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。

After mated the connector, please do not allow the printed circuit boards to apply pressure on the connector in either the pitch direction or the span direction. It may cause damage to the connector and may crack the soldering.

3-13 本品に強い衝撃や強い負荷が加わると、瞬間的にカード検知スイッチとシェルが同電位になることが有ります。

Electric potential of Detect Switch is equal to it of Shell for an instant, when this item is shocked and pressurized hard.

3-14 本品は小型化を主眼とした製品であるため、各部の肉厚等が非常に薄く設計されており、実装後にメタルシェルネイル部、ターミナルテイル部がPCボードに固定された状態で剛性が満足する様に設定されています。

したがって、実装前の単体状態では部分的に強度が弱い箇所もあり、変形等が懸念されるため、取り扱いには十分注意して下さい（地面への落下禁止、カード挿抜禁止等）。

Due to be focused on miniaturization on this product, each wall thickness of parts are designed to be thinner, then, connector stiffness is designed to be satisfied under metal shell nails and terminal tails are mounting on the PC board.

Therefore, care should be taken when handling before mounting due to be concerned on parts strength, deforming etc.

(Prohibited matter before soldering. is to be dropped to the ground or card is inserted, withdrawn etc..)

・リペアについて Repair

4-1 実装後において半田ごてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。

When conducting manual repairs using a soldering iron, please follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product spec are not followed, it may cause the terminals to fall off, a change in the contact gap, a deformation of the housing, melting of the housing, and damage the connector.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 14 of 16
EN-037(2012-05)			

4-2 半田ごてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。

When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

・ その他 Others

5-1 本製品はカード飛び出し制御に重点を置いている為、カードの仕上がり状態により自然な排出がされない場合があります。この場合、カードを取り出し後、排出機構に異常が無ければ、コネクタとしては良品と判断しております。

As for this product, it gives priority to the card dashing out control, and the card discharge might not be done by the finishing condition of card. In this case, if the push/push mechanism of connector is no damage after taking out the card from the connector, as a connector, it will be judged as the excellent article.

5-2 コネクタに直接力が加わると、コネクタの変形を起こす可能性やカード排出性に影響がございます。

コネクタ上面から筐体までにコネクタMAX高さから十分なクリアランスを設けてください。コネクタに直接力が加わる時は別途ご相談をお願いします。

When this item is shocked and pressurized hard, there is possibility to occur deformity and card sticking. Therefore, please make suitable clearance on the top of MAX height connector. If your phone design can't prevent from damaging connector, please confirm it.

5-3 コネクタに短時間に過度な衝撃を加えると変形や破壊を起こす可能性がございます。コネクタへの過度な衝撃が加わらないように考慮した筐体デザインにさせていただきますよう、お願いいたします。

There is possibility to occur deform it, when the connector is over-shocked for a short time. Please make sure design your phone chassis to be free from over-shock to connector.

5-4 この製品は、カード飛び出し制御に重点を置いているため、カードの状態及びコネクタ搭載位置によっては、仮保持位置からのカードが取出しづらい場合がございます。特にカード上面から爪で引っかき出すような取出し方の場合、カード形状に依存して取出しが困難になる恐れがあります。

This product focuses on the card flying out prevention. Therefore the card might not be taken out easily from CARD dashing position according to the card condition and the connector's equipped position.

Especially in the case of pulling out the card scratching on the card top surface, it might be difficult to take out depending on the card shape.

5-5 セットへの組み込み後、コネクタに直接大きな振動及び負荷等が加わらない様に、取り付け基板に固定対策をして下さい。

After mounting of connectors, connectors shall be fastened to printed circuit boards where connectors are mounted so that connectors are free from direct excessive vibration and force..

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 16	micro SD CONN. (PUSH/PUSH & NORMAL ULTRA LOW-PRO TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-503182-006		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 16	SHEET 15 of 16
EN-037(2012-05)			

